



**平成23年3月期
（第9期）
第2四半期決算説明会**

**平成22年11月5日
株式会社ジーダット**

平成23年3月期第2四半期決算のポイント

上期計画比:売上高 Δ 3.1%、経常利益+214%

市場別売上高;半導体 Δ 6%、FPD+1%

上期前年同期比:売上高+4.6%、経常利益+496%

市場別売上高;半導体 Δ 2%、FPD+15%

上期研究開発投資及び製品開発はほぼ計画通り

通期予想は変更せず

上期実績 -前年同期比・計画比-

(単位:百万円)

	平成22年 3月期実績	平成23年3月期			
		当初 計画	実績	前年同期 比	当初計画 比
売上高	694	750	726	+4.6%	△3.1%
売上総利益	464	511	527	+13.6%	+3.2%
販売費及び 一般管理費	515	504	496	△3.8%	△1.7%
営業利益	△51	6	31	-	+375.0%
経常利益	6	13	40	+496.7%	+214.8%
当四半期 純利益	△4	7	24	-	+216.2%

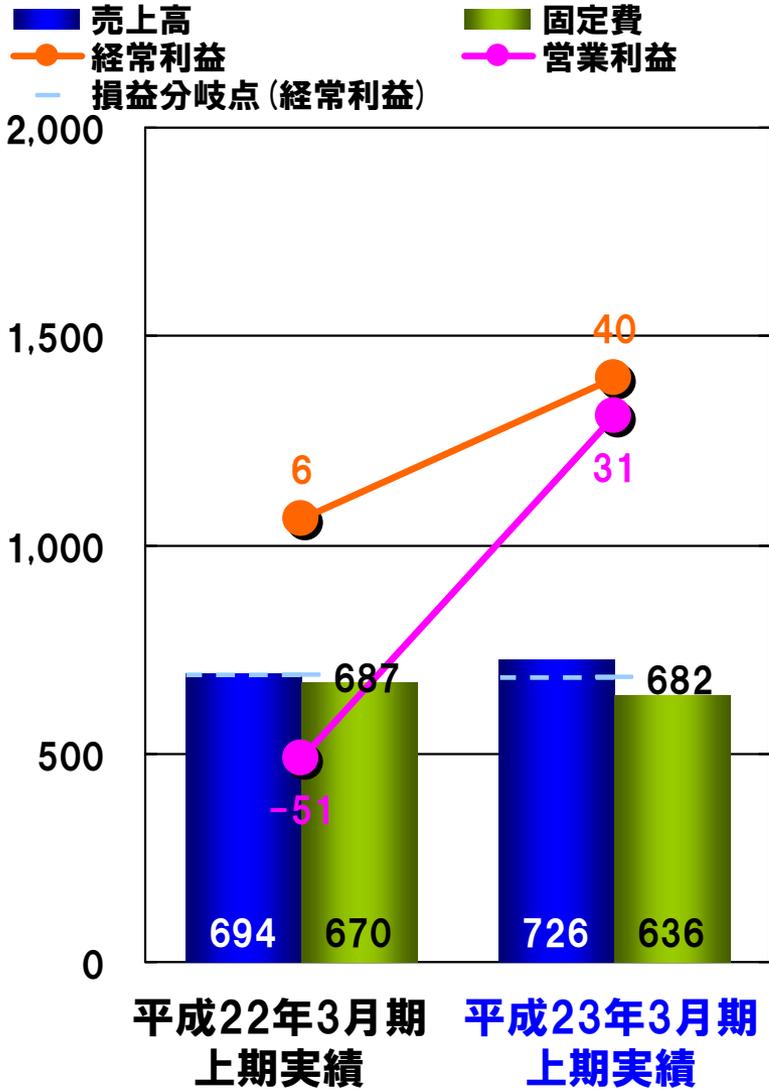
通期予想 -前年同期比-

(単位:百万円)

	平成22年3月期 実績	平成23年3月期	
		通期予想	前年同期比
売上高	1,512	1,600	+5.8%
売上総利益	1,025	1,096	+6.9%
販売費及び 一般管理費	1,089	1,046	△3.9%
営業利益	△64	50	—
経常利益	60	61	+2.1%
当期純利益	24	35	+43.0%

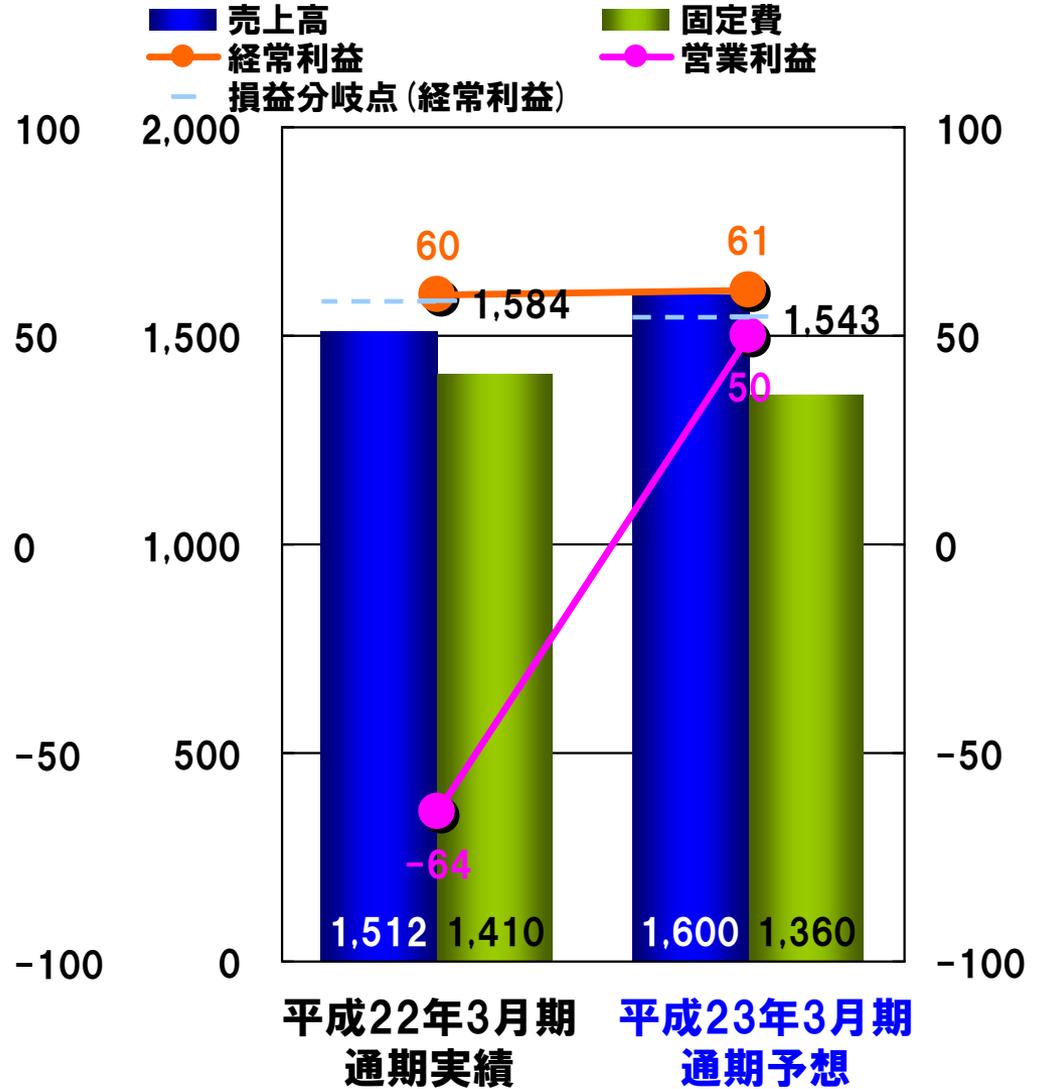
売上高・利益 - 前年同期比 -

【上期】



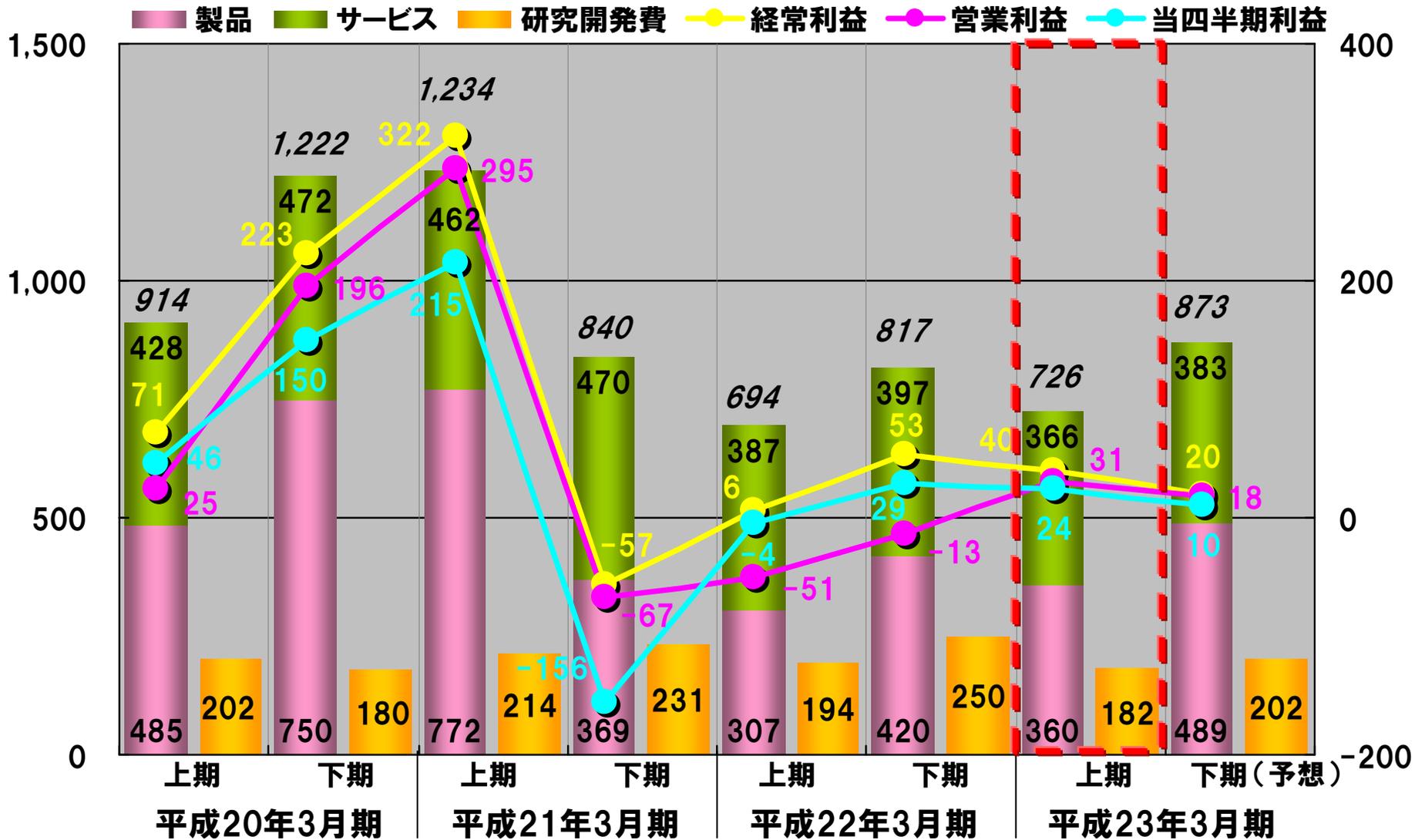
【通期】

(単位:百万円)



半期毎売上高・利益の推移

(単位:百万円)



連結貸借対照表 - 前期末比 -

(単位:百万円)

	平成22年 3月期末	平成22年 9月30日	差異		平成22年 3月期末	平成22年 9月30日	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	2,070	2,478	408	I 流動負債	248	347	98
1 現金及び預金	1,681	2,192	511	1 買掛金	48	34	△14
2 受取手形及び売掛金	291	194	△97	2 未払法人税等	6	6	△0
3 たな卸資産	7	11	3	3 賞与引当金	55	52	△2
4 繰延税金資産	33	26	△6	4 その他	138	253	114
5 その他	55	53	△2	負債合計	248	347	98
II 固定資産	613	307	△305	(純資産の部)			
1 有形固定資産	35	32	△2	I 株主資本	2,435	2,441	5
2 無形固定資産	30	27	△3	1 資本金	760	760	—
3 投資その他の資産合計	547	247	△299	2 資本剰余金	890	890	—
長期貸付金	1	0	△0	3 利益剰余金	818	823	5
繰延税金資産	196	191	△4	4 自己株式	△32	△32	—
長期預金	300	0	△300	II 評価・換算差額等	△1	△2	△1
その他	49	55	5	その他有価証券評価差額金	—	—	—
				為替換算調整勘定	△1	△2	△1
				純資産合計	2,434	2,439	4
資産合計	2,683	2,786	102	負債純資産合計	2,683	2,786	102

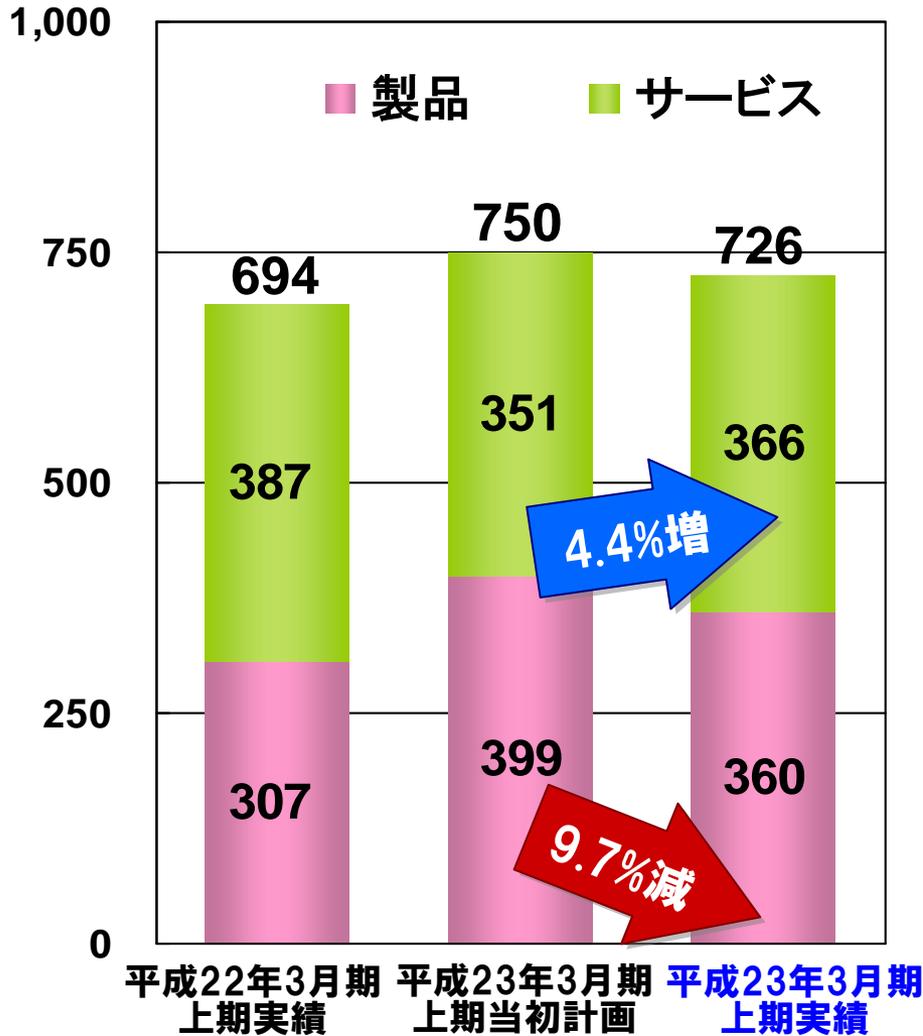
連結キャッシュフロー計算書 - 前年同期比 -

(単位:百万円)

	平成21年4月1日 ～ 平成21年9月30日	平成22年4月1日 ～ 平成22年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	86	243	156
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	11	△411	△422
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△38	△19	19
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	2	△1	△3
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	61	△188	△250
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,070	981	△89
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,132	792	△339

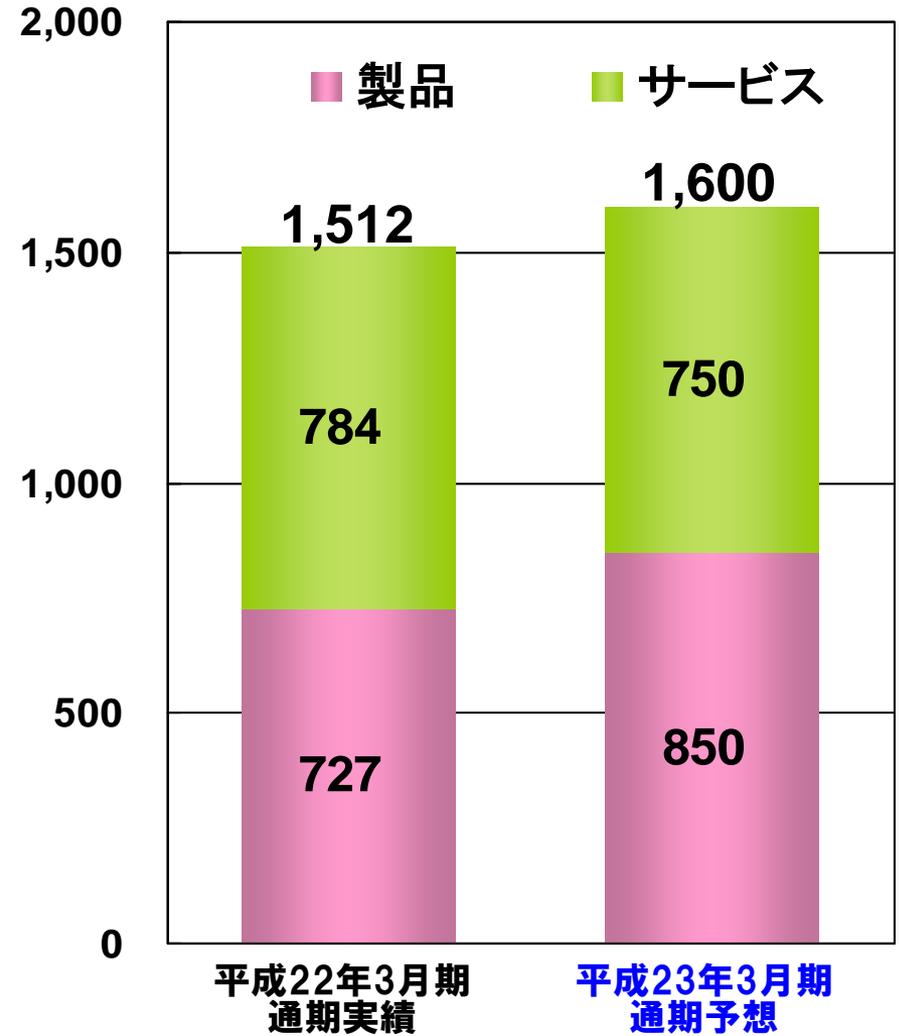
事業別売上高（製品/サービス） - 計画比 -

【上期】



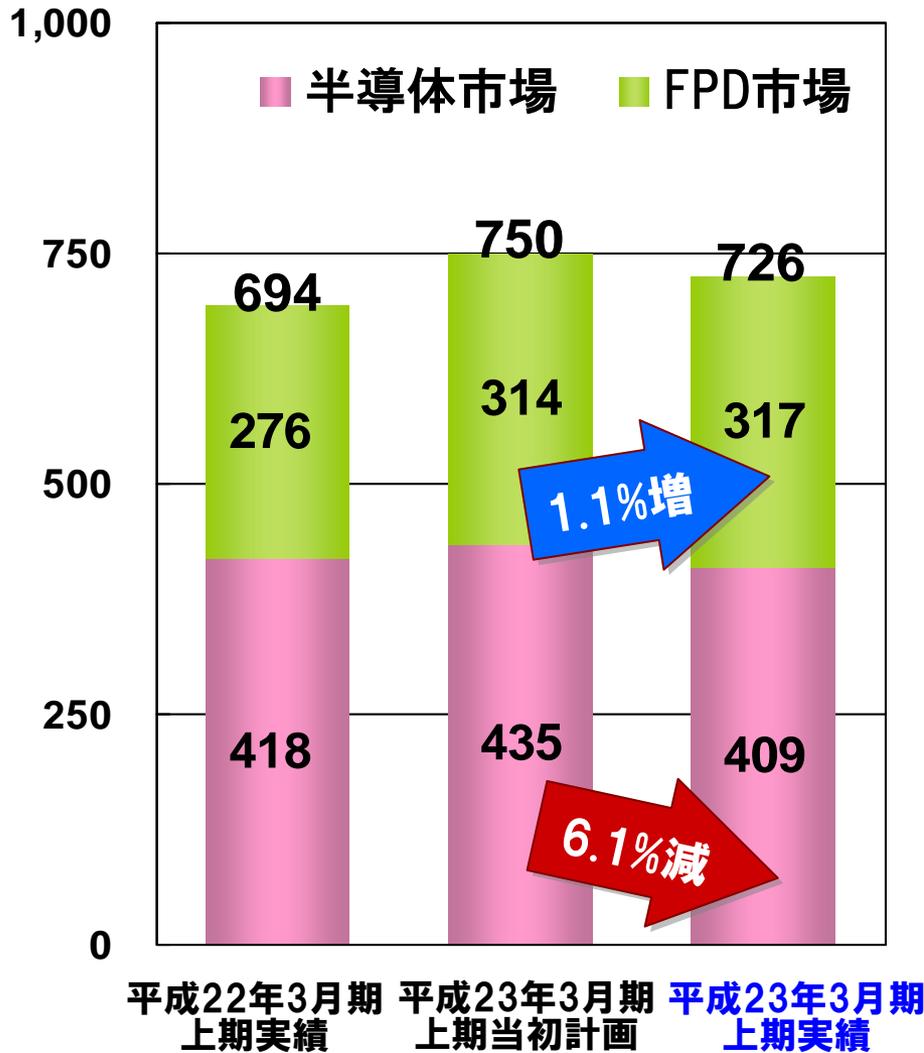
【通期】

(単位:百万円)



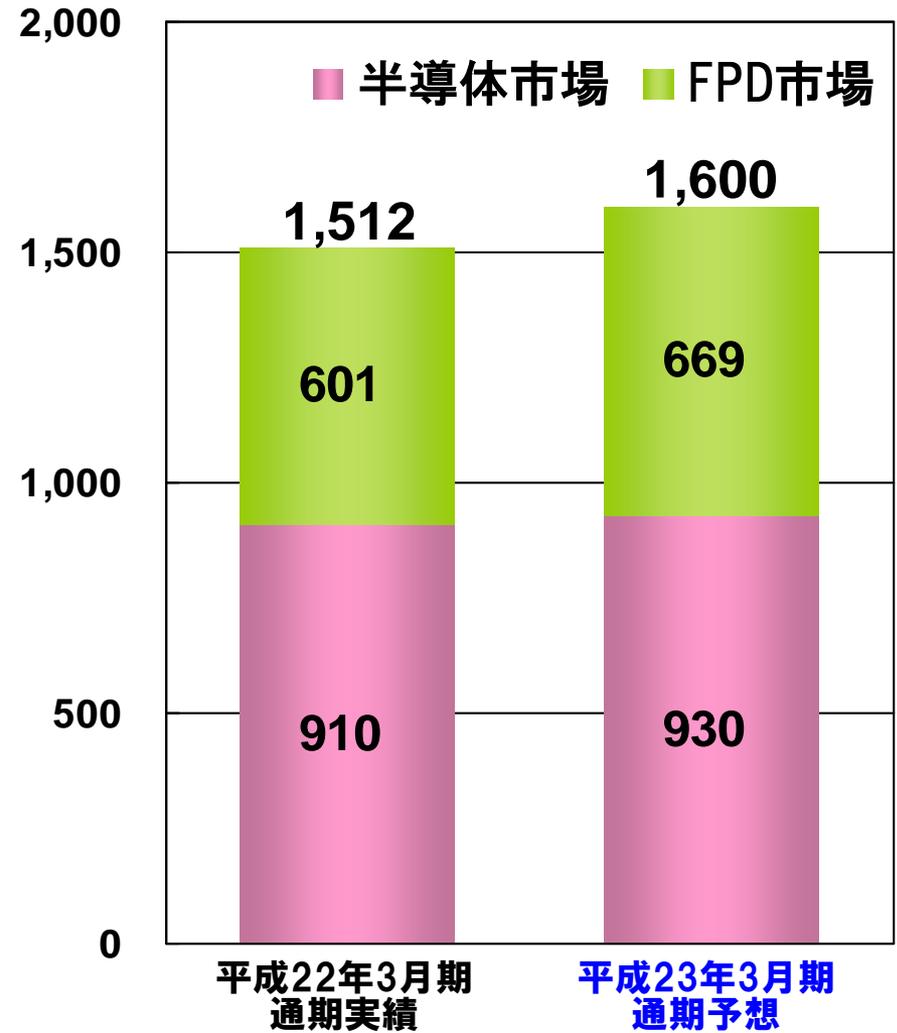
市場別売上高 (半導体/FPD) - 計画比 -

【上期】



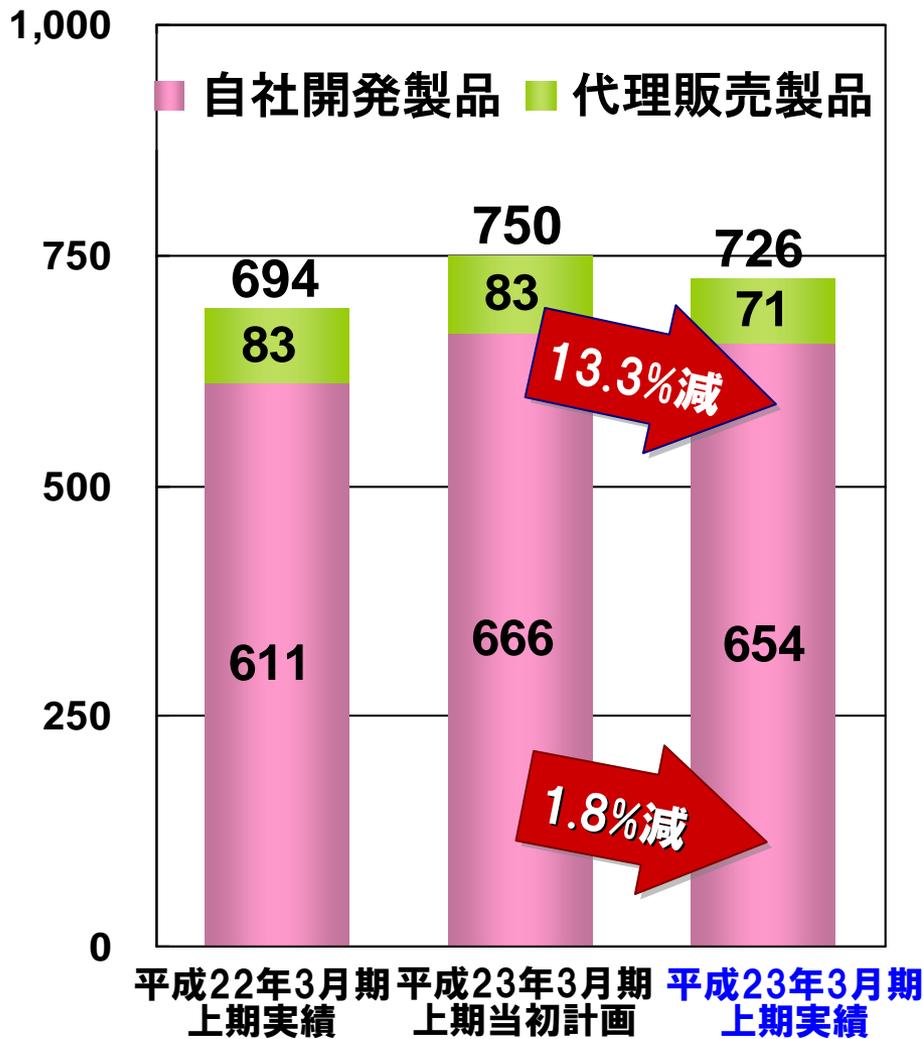
【通期】

(単位:百万円)



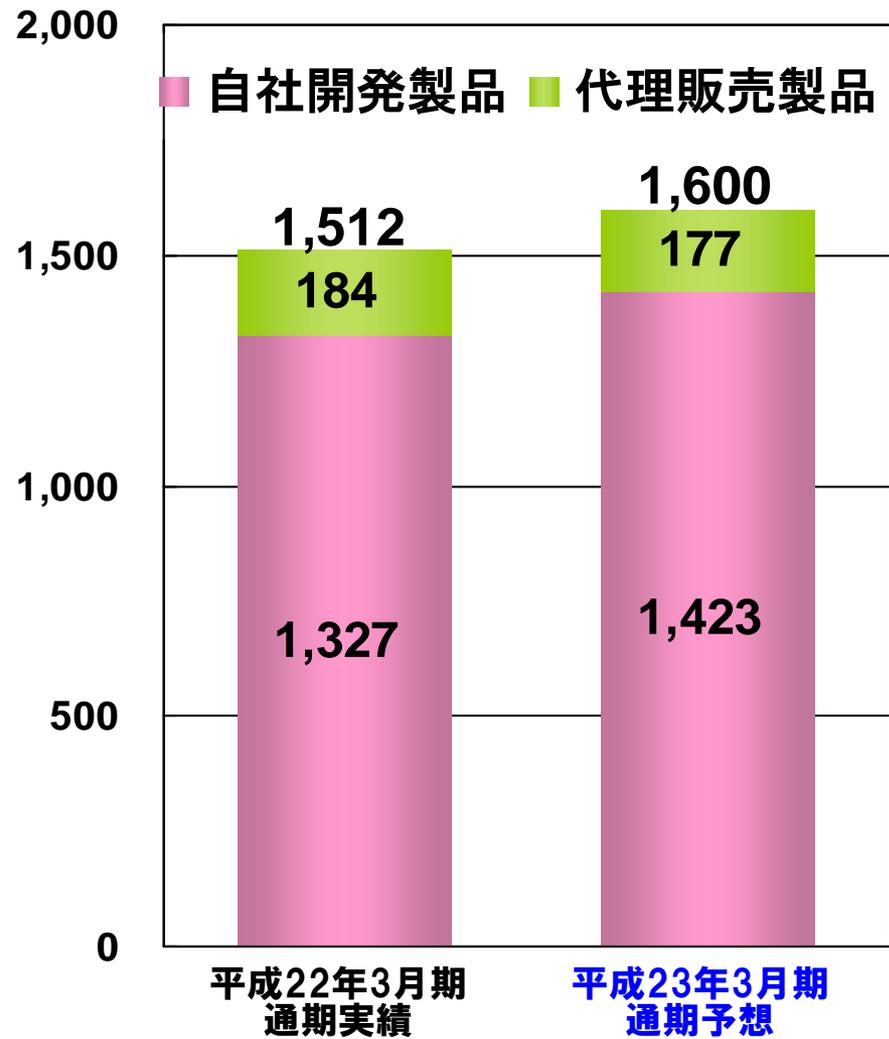
製品区分別売上高（自社開発／代理販売）-計画比-

【上期】



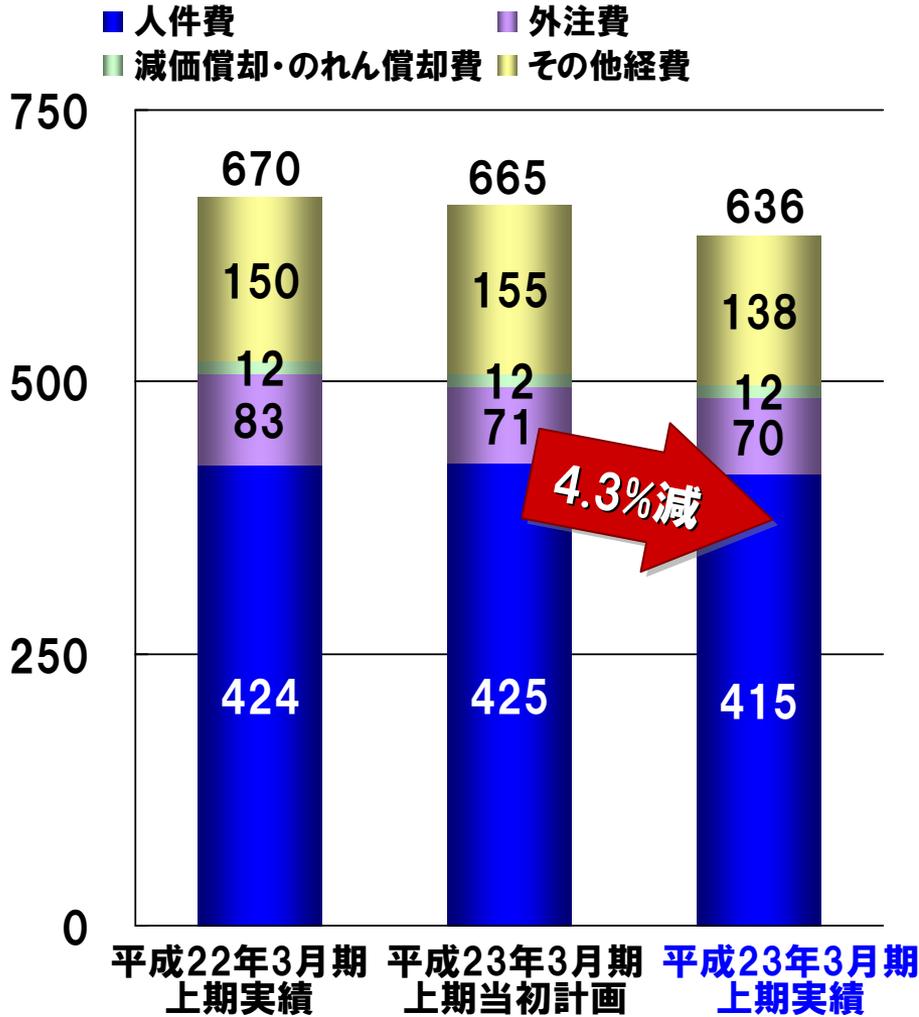
【通期】

(単位:百万円)



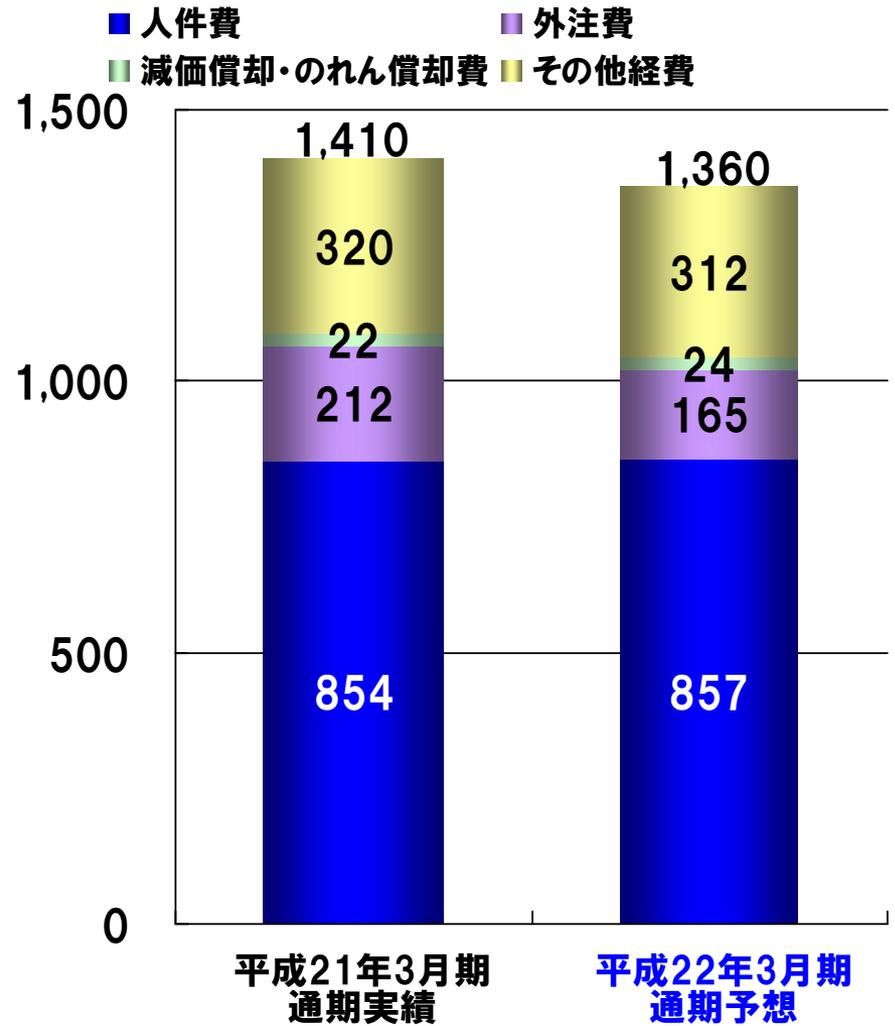
固定費内訳 -計画比-

【上期】



【通期】

(単位:百万円)



研究開発費 - 計画比 -

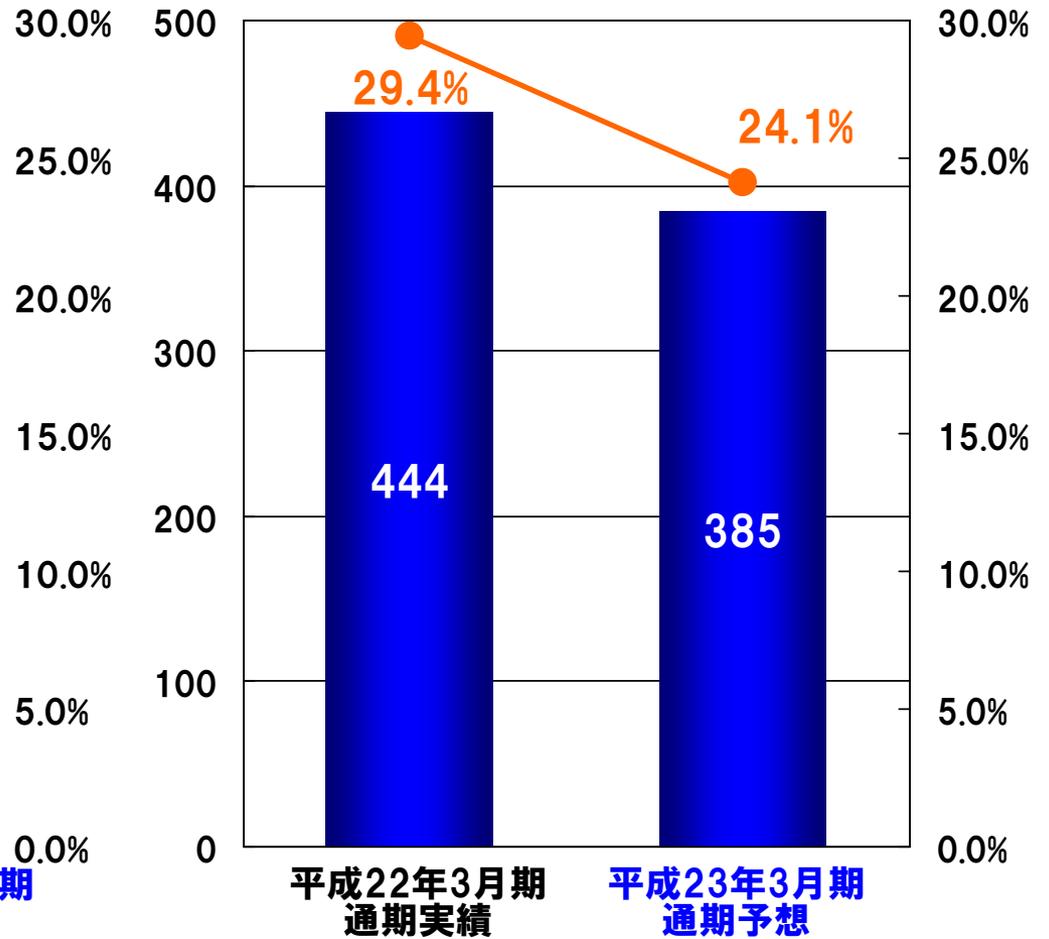
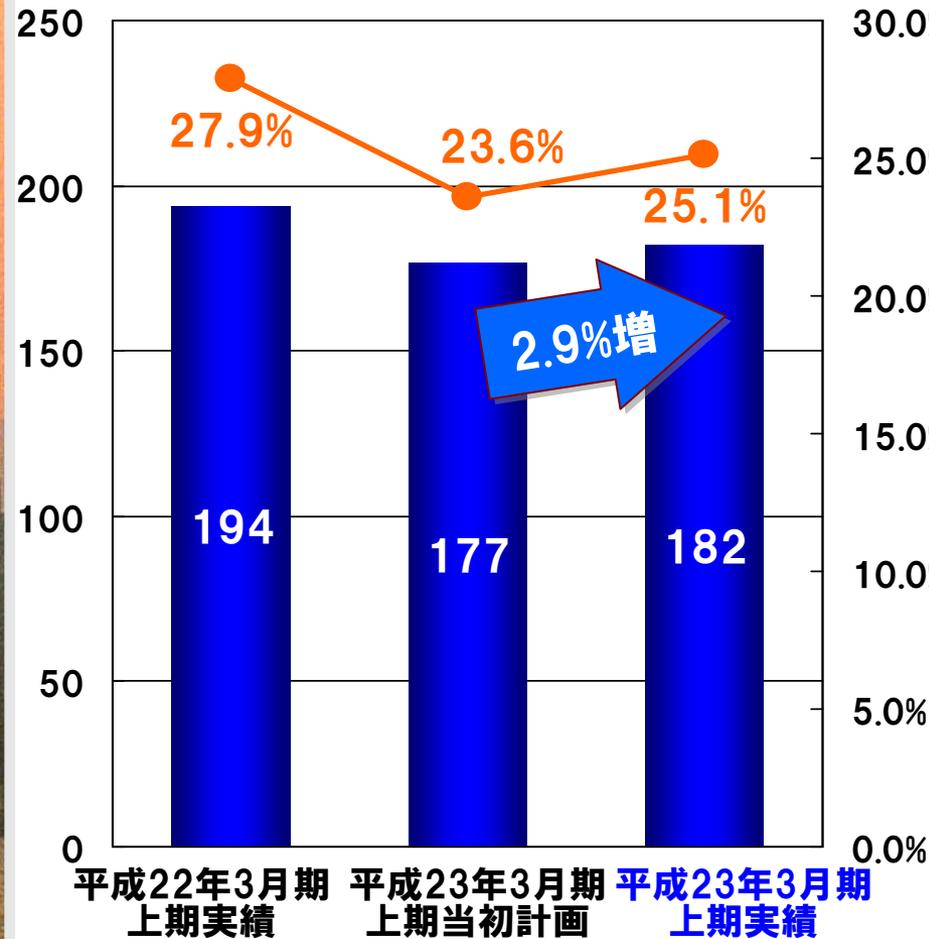
【上期】

【通期】

(単位:百万円)

■ 研究開発費 ● 売上高比

■ 研究開発費 ● 売上高比

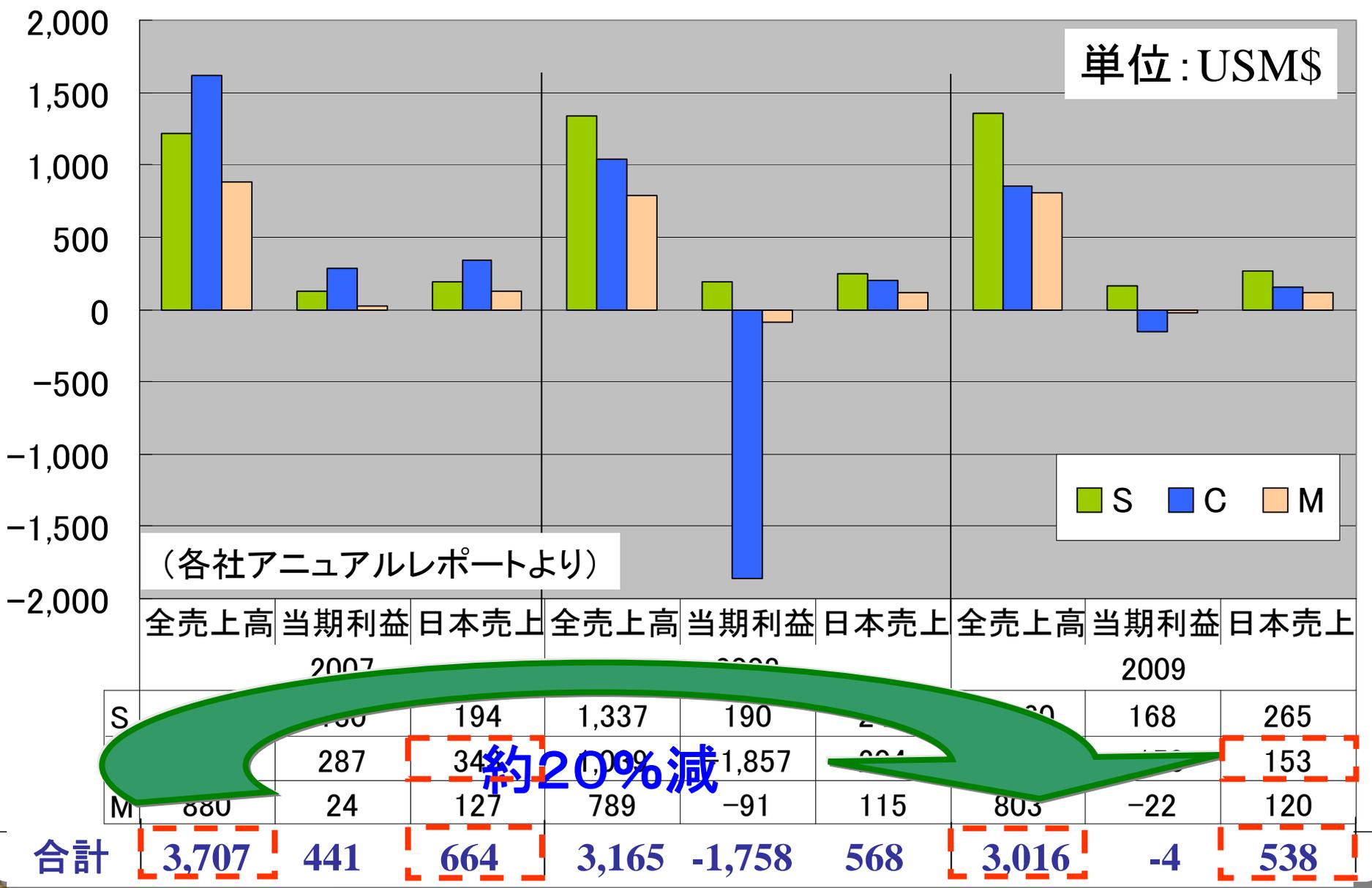


主なトピックス

- 米国ATopTech社との技術提携発表 (6月)★
- デバイスTEG自動設計ツール: **TEGpert** 発表 (6月) **新製品**
- 統合回路設計ツール: **C³ (Circuit-Cube)** 大幅機能強化 (10月)★
- 電源解析ツール: **PowerVolt** 発表 (10月) **新製品**★
- 光シミュレータ電磁光学解析オプション:
ExpertLCD LCDMaxオプション発表 (10月) **新製品**
- 液晶パネル専用・回路シミュレータ:
MSIM-LCD / Hybridモデル 発表 (10月) **新製品**
- **プライベート・フェア**開催 東京、大阪 (10月)
 - ◆ 昨年を上回る参加者数
 - ◆ 上記新製品等発表
 - ◆ **C³ (Circuit-Cube) のユーザ評価結果発表**



EDA市場動向(Big3のトレンド)



EDA大手ベンダと国内EDA顧客の葛藤

国内EDA市場：成熟から縮小へ

包括
契約

EDA大手の戦略：現契約金額維持

→ライセンス数削減には単価値上げで対抗

→金額維持ならライセンスフリーもOK

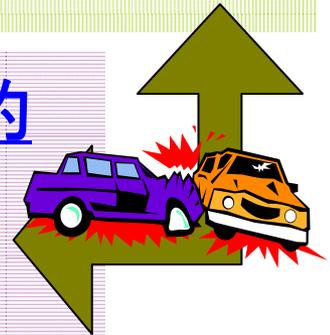
落とし所は最小減額と多年度契約？

EDA顧客の課題：EDAコスト大幅削減、単年度契約

→ 契約更新時の大手離れ

→ 一層の大手集約とその他EDAの解約

→ 大手一本化＋その他EDA



包括契約の壁

包括契約の壁のブレイク

半導体大手顧客
幅広い品種、SoC

包括契約

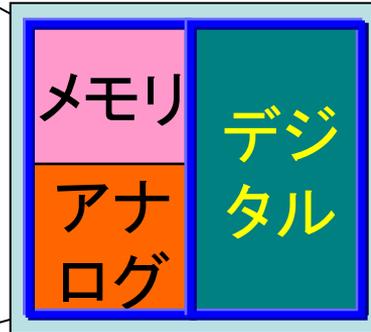
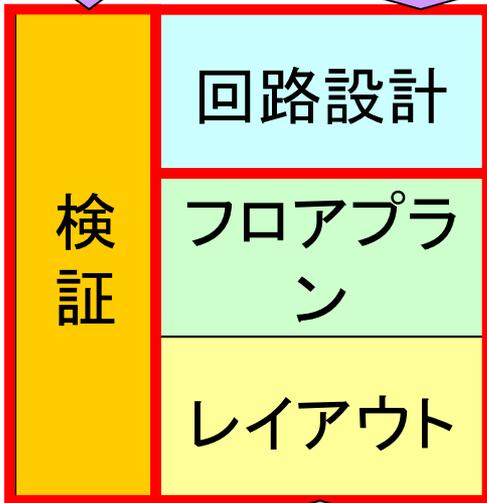
定額フリーライセンス

大手EDA
幅広い製品群

PowerVolt

C³ (Circuit Cube)強化

SoC
(System on Chip)

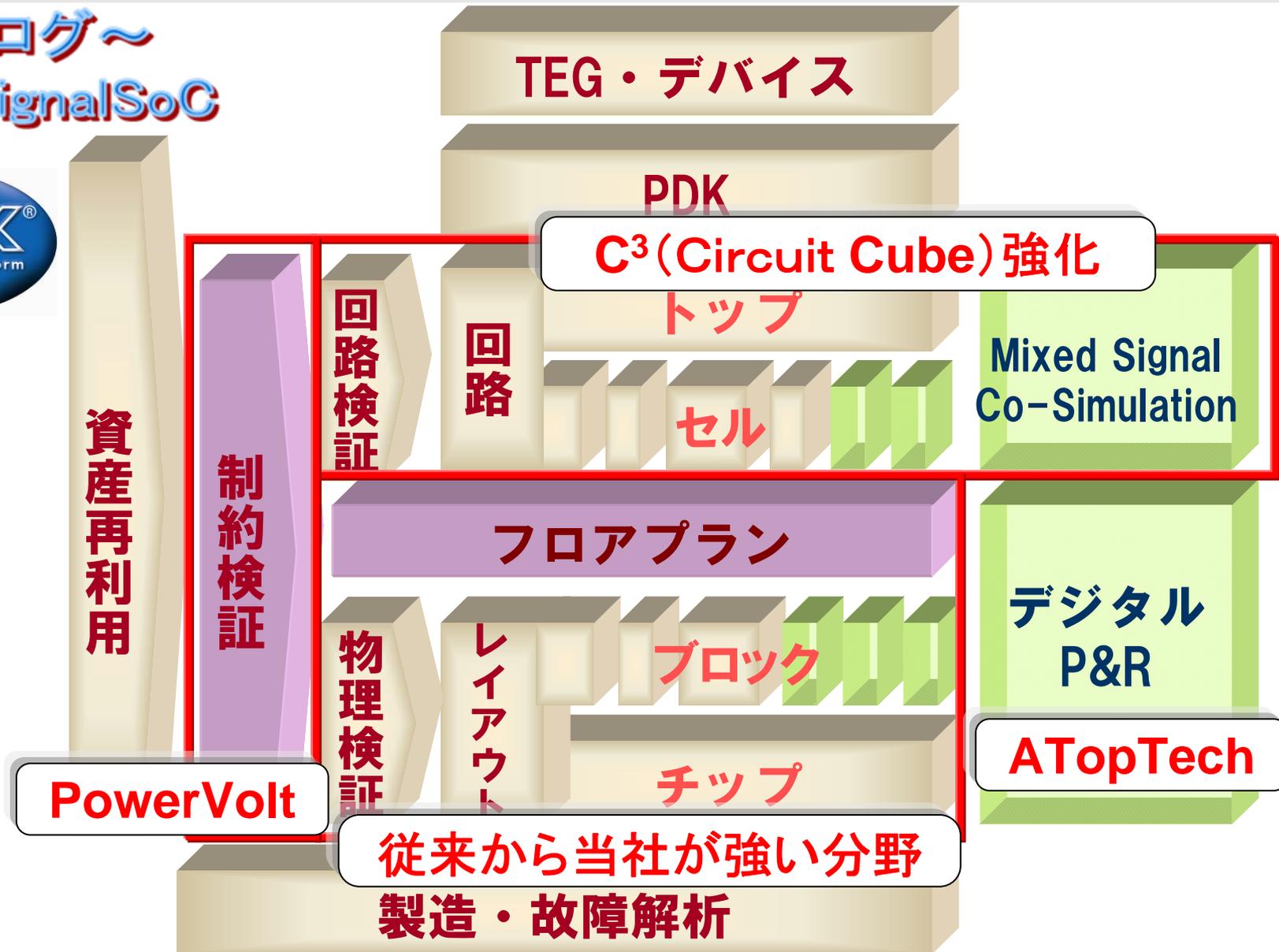


従来から当社が強い分野

ATopTech社との提携

アナログ関連設計総合環境

アナログ～
MixedSignalSoC



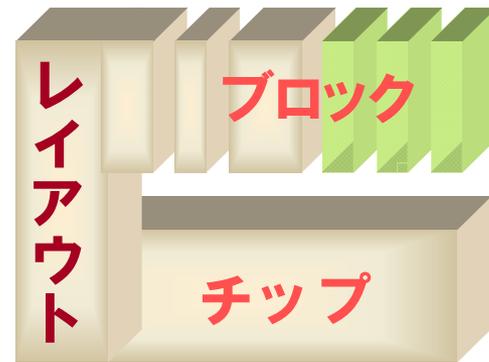
A TopTech社 デジタルP&Rとの連携

アナログ設計＋先端P&R (自動配置配線)による

Mixed Signal SoC設計環境

ブロック配置・形状
配線 (電源・バス)
リピータ挿入・ピン配置

JEDAT



- ・0.35 μ - 28nm
- ・MCM、OCV
- ・Multi-Vdd
- ・DFM rule
- ・Multi-thread/CPU

ブロック内自動配置配線
パスタイミング
クロック解析

当社の戦略まとめ

国内EDA市場は縮小傾向

➤ 半導体：大手リプレース～包括契約の壁

- 回路設計ツール強化：アナログ等設計全工程のリプレース
- ATopTech社提携：SoCユーザリプレース
- 品質検証ツール強化（動作不良検証から信頼性・脆弱性検証に拡張）：アナログ等設計における差別化

C³強化

PowerVolt

ExpertLCD LCDMax op.

➤ FPD：画素数増加への対応と応用分野の開拓

- 光シミュレーション精度向上：波動光学から電磁光学解析への拡張
- 回路シミュレーション精度向上：自動フィッティング機能付拡張モデル
- LED照明、太陽光発電受光素子等への応用

➤ 海外販売強化

- 海外営業本部新設（本部長ヘッドハント）
- 中国・北京子会社に営業部門新設

MSIM-LCD
Hybridモデル

当社の強みを伸ばす～顧客への貢献

JEDATの強み

大幅な
TAT短縮
が必ず出
来ます。

リーマン危機後の反応

人が余っているから人海戦術
でいく。問題はEDAコストだ。

TAT短縮しても、仕事が増え
るだけ。給料も上がらない。

新しいツールを評価する人も
いないし、時間もない。

稟議書なんかどうせ通らない。

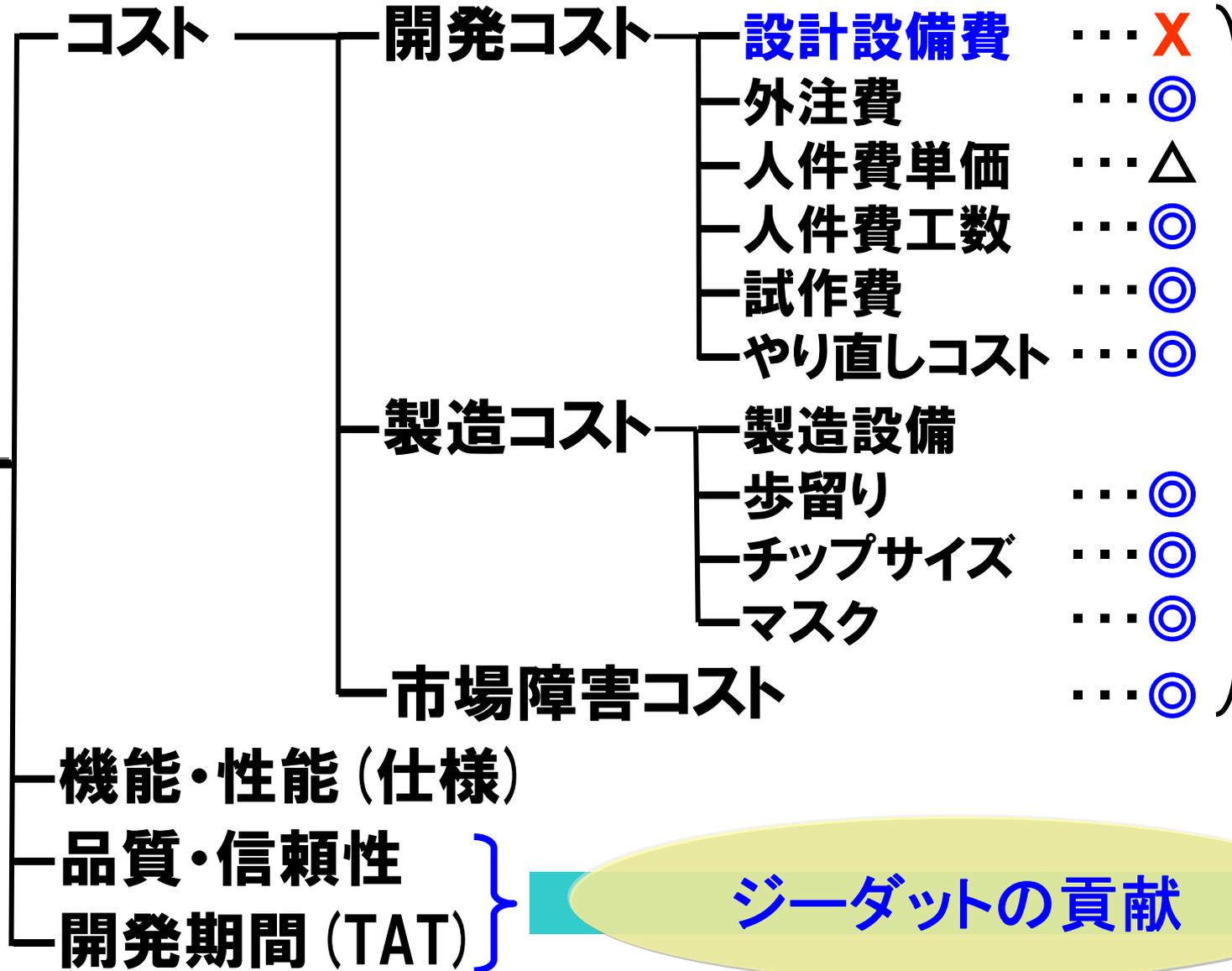


JEDAT

継続的な競争力向上のための次の手は？

顧客の競争力向上～当社の貢献

競争力の要素



ジーダットEDA製品開発コンセプト

目標1/10!

➤ **TAT短縮**のブレイクスルーと
設計品質の飽くなき向上

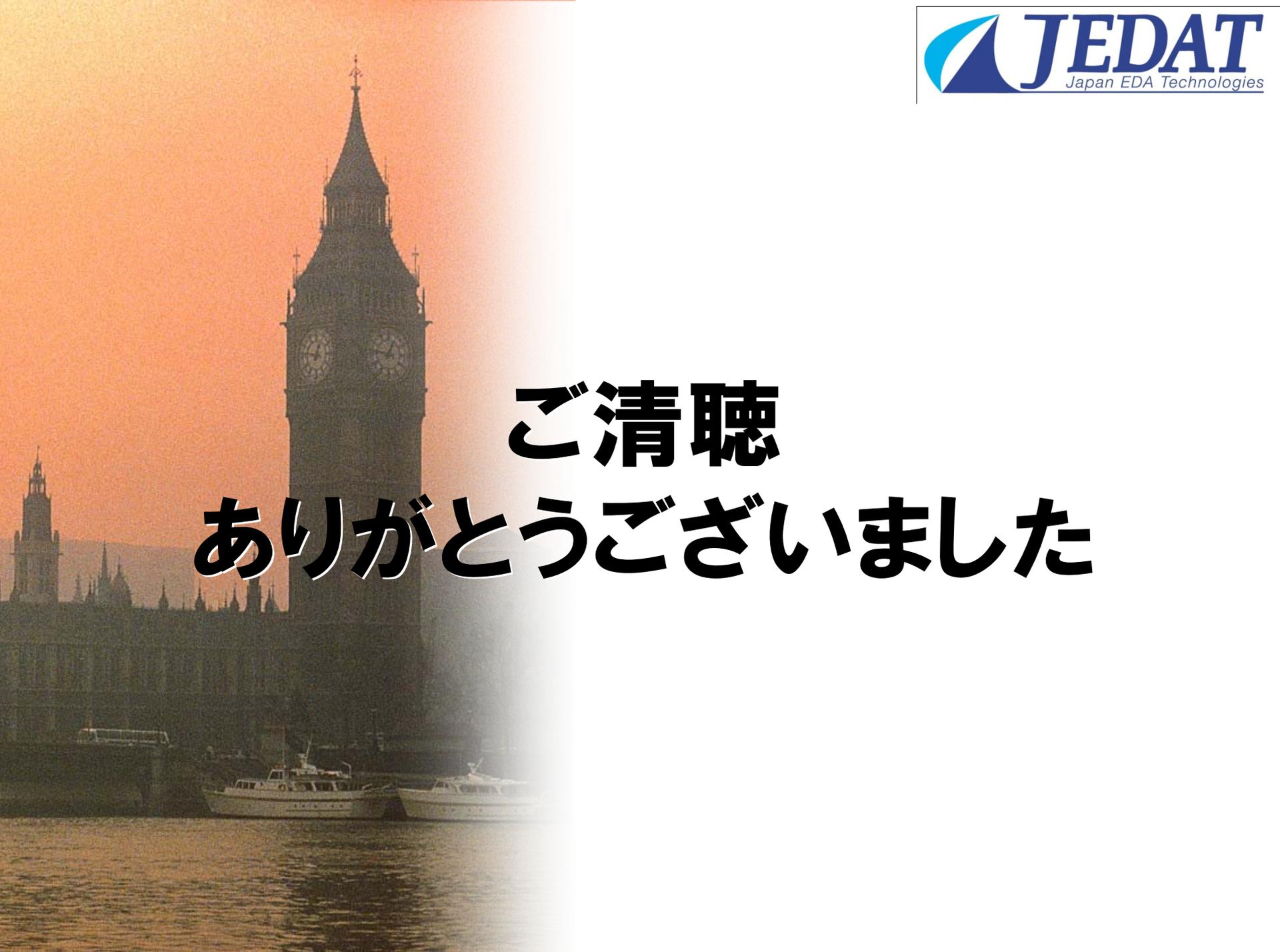
従来の動作不良
検証に加えて歩
留り、信頼性、脆
弱性……

➤ 設計ノウハウの**蓄積・共有**と
設計資産の**再利用**

➤ 設計者に感動を与える**使い易さ**の追求

➤ 他社メジャーツールI/Fの充実と
標準化対応

(JEDATカタログより)



**ご清聴
ありがとうございました**